

【OFC 2026】矽格進軍全球光通訊指標展會 搶攻 AI、矽光子與高速傳輸封測商機

隨著生成式 AI、雲端運算與資料中心基礎建設快速升級，帶動高速互連、光通訊、矽光子與先進封裝需求持續升溫，半導體封裝測試廠矽格宣布，將參加 OFC 2026，並於 美國洛杉磯會議中心 (Los Angeles Convention Center) West Hall 4673 展出，鎖定 AI 基礎建設、高速傳輸、矽光子與高階測試應用所衍生的新一波市場商機。OFC 2026 技術會議於 2026 年 3 月 15 日至 19 日舉行，展覽日期為 3 月 17 日至 19 日。

OFC 為全球光通訊與光網路產業最具代表性的年度展會之一，長年匯聚光通訊元件、系統設備、資料中心、高速網路與半導體供應鏈重要業者。根據主辦單位資訊，OFC 2026 展區已售罄，反映 AI 驅動下之網路升級與頻寬需求正快速擴大，也使本屆展會成為觀察全球光通訊、矽光子與資料中心技術走向的重要風向球。

矽格表示，面對 AI 伺服器、高效能運算 (HPC)、雲端資料中心及高速交換架構持續朝向更高頻寬、更低延遲與更高能效發展，封裝與測試已成為支撐新世代半導體產品量產導入、品質穩定與系統可靠度的關鍵環節。此次參與 OFC 2026，將聚焦 AI、ASIC、HPC、網通、矽光子及高可靠度應用 等市場，展現公司在先進封裝與高階測試領域的整體技術實力與服務能力。

在 AI 資料中心加速擴建、光模組傳輸速率持續提升，以及矽光子與光電整合技術加速導入的帶動下，市場對測試精度、製程穩定度與供應鏈協同能力的要求同步升高。矽格近年持續投入 智慧製造、製程自動化、數據化管理與高階測試平台 建置，藉由整合設備、工程與製造管理能力，提升品質一致性、可追溯性與生產效率，以因應高階晶片與高速通訊元件日益提升的封測需求。

本屆 OFC 展會聚焦 AI-era data centers and networks，涵蓋光通訊系統、矽光子、光模組、雷射、元件，以及支援大規模高效能運作所需之測試與量測工具，顯示光通訊基礎建設升級正與 AI 發展形成更緊密的產業連動。對矽格而言，參與 OFC 不僅是拓展國際客戶與合作夥伴的重要平台，也有助於掌握下一代高速傳輸與光電整合應用趨勢，進一步強化在全球高階封裝測試供應鏈中的競爭優勢。

矽格指出，未來將持續以 Advanced Test Technology、Automation、AI Factory 為核心發展方向，深化先進封裝與測試整合能力，積極布局 AI、光通訊、矽光子與高速網路等高成長應用市場，攜手全球客戶共同迎接新世代半導體產業升級契機。

展覽資訊

展覽名稱：OFC 2026

展覽日期：2026 年 3 月 17 日 (二) 至 3 月 19 日 (四)

技術會議：2026 年 3 月 15 日 (日) 至 3 月 19 日 (四)

展覽地點：Los Angeles Convention Center, Los Angeles, California, USA

攤位編號：West Hall 4673



Sigurd 矽格股份有限公司
SIGURD MICROELECTRONICS CORPORATION

invitation 邀請函

OFC The Future of Optical Networking
and Communications - Los Angeles, CA
March 17-19 (Tue-Thu), 2026

展會時間 Exhibition Date
2026年03月17日(週二)至19日(週四)
Mar 17-18 (Tue-Wed) | 10:00 – 17:00 (PT)
Mar 19 (Thu) | 10:00 – 16:00 (PT)

展位號碼 Booth No.
4673 (West Hall)

展會地點 Exhibition Location
美國加州洛杉磯會展中心
Los Angeles Convention Center
Los Angeles, California, United States

矽格十年磨一劍，精研技術、打造封測系統與品質
歡迎半導體先進舊雨新知，蒞臨指導

Best In and Out OSAT Solutions
Sigurd MICROELECTRONICS CORP.
矽格股份有限公司

Sigurd Provides Comprehensive Service

SIGURD MICROELECTRONICS CORP.
TAIWAN